

| REV. | MODIFICATION | ECN No | NAME | DATE |
|------|--------------|--------|------|------------|
| A0 | △新原发行 | | 宋添红 | 2017-02-24 |
| | | | | |

| | |
|-----|-------------|
| B12 | GND |
| B9 | VBUS |
| B5 | CC2 |
| A5 | CC1 |
| A9 | VBUS |
| A12 | GND |
| PIN | SIGNAL NAME |

PCB 制造要求:

- 1.1 板厚: 1.6mm
- 1.2 铜厚: 35μm
- 1.3 铜厚: 35μm For 1 mil
- 1.4 铜厚: 35μm
- 1.5 铜厚: 35μm
- 1.6 铜厚: 35μm
- 1.7 铜厚: 35μm
- 1.8 铜厚: 35μm
- 1.9 铜厚: 35μm
- 1.10 铜厚: 35μm
2. 表面处理:
 - 2.1 表面处理: ENIG
 - 2.2 表面处理: ENIG
 - 2.3 表面处理: ENIG
 - 2.4 表面处理: ENIG
 - 2.5 表面处理: ENIG
 - 2.6 表面处理: ENIG
 - 2.7 表面处理: ENIG
 - 2.8 表面处理: ENIG
 - 2.9 表面处理: ENIG
 - 2.10 表面处理: ENIG
3. 材料要求:
 - 3.1 材料: LCP
 - 3.2 材料: SUS201
 - 3.3 材料: GND

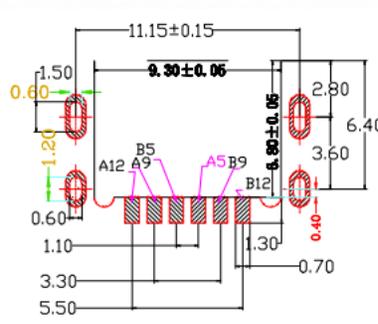
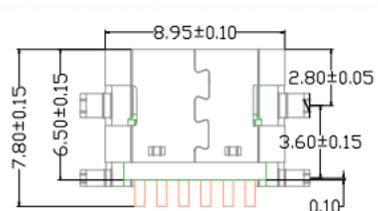
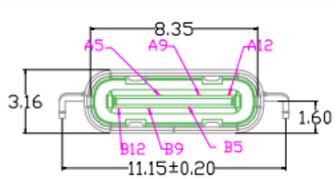
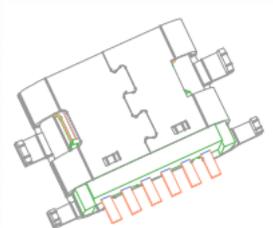
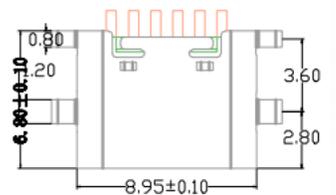


Table:

| 成品料号 | 零件名称 | 零件料号 | 材料 / 电镀 |
|---------|------|------|--------------------|
| TCB1342 | 端子 | TX | cu |
| | 绝缘材料 | TX | LCP94v |
| | 外壳 | TX | SUS 201 R-H 电镀铜镍合金 |

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| .X: ±0.35 | .X': ±1.5' | INTENDED USE: | TITLE: |
| .XX: ±0.25 | .XX': ±1.0' | CONNECTOR | TYPE C 母 PCB 板 1.0 |
| .XXX: ±0.20 | .XXX': ±0.5' | APPD.: | PART NO.: |
| MAT'L: | SEE NOTES | CHKD.: | DWG. NO.: T16-000X |
| FINISH: | | DR.: Len.Song | SCALE: 1:1 PAGE: 1/1 |
| | | | UNIT: mm REV.: A0 |